中信证券股份有限公司

关于上海艾为电子技术股份有限公司

部分募投项目子项目调整及延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对艾为电子部分募投项目子项目调整及延期事项进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10 日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第 4-00042 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G 射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		**246,813.72**	**246,813.72**

公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金 47,220.00 万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为 47,747.45 万元，拟使用剩余超募资金 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		**47,747.45**	**47,220.00**

公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项后，公司拟将剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、现金管理收益 1,251.13 万元，合计约 20,183.60 万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”，并调整募集资金投资项目“电子工程测试中心建设项目”的内部投资结构。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由 73,858.20 万元变更为 94,041.80 万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由 73,858.20 万元变更为 94,041.80 万元（具体金额以划拨日为准）。公司于 2023 年 12 月 5 日进行了划拨，实际划拨金额为 20,205.00 万元，实际投资总额变更为 94,063.20 万元。

三、募集资金使用情况

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59	44,164.59	41,298.56
2	5G 射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05	21,177.05	15,623.49
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12	36,789.12	26,687.05
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76	21,892.29	21,892.29
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20	94,063.20	68,105.95
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	17,668.27
7	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00	47,220.00	15,270.68
合计		**294,561.17**	**294,033.72**	**295,306.25**	**206,546.28**

注 1：调整后使用募集资金投入金额包含首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注 2：上述累计投入金额为截至 2025 年 6 月 30 日数据。

四、本次部分募投项目子项目调整情况

（一）本次部分募投项目子项目调整的具体情况

1、公司“发展与科技储备资金”项目具体情况

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）
1	高压 BCD 先进工艺导入	6,500.00	6,500.00	6,679.89
2	基于 RISC-V 架构的 SoC 平台	4,800.00	4,800.00	-
3	电荷泵快充和光学防抖的技术开发	8,700.00	8,700.00	988.38
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		**30,000.00**	**30,000.00**	**17,668.27**

注：上述累计投入金额为截至 2025 年 6 月 30 日数据。

2、公司“发展与科技储备资金”项目子项目调整情况

公司拟将高压 BCD 先进工艺导入投资金额由 6,500 万元变更为 14,000 万元，基于 RiscV 架构的 SoC 平台投资金额由 4,800 万元变更为 2,000 万元，电荷泵快充和光学防抖的技术开发由 8,700 万元变更为 4,000 万元。“发展与科技储备资金”

项目使用募集资金投资总额保持不变，具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整前使用募集资金投入金额（万元）	调整后使用募集资金投入金额（万元）
1	高压 BCD 先进工艺导入	6,500.00	14,000.00
2	基于 RISC-V 架构的 SoC 平台	4,800.00	2,000.00
3	电荷泵快充和光学防抖的技术开发	8,700.00	4,000.00
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		**30,000.00**	**30,000.00**

（二）本次部分募投项目子项目调整的原因

由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，因此拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整。

由于 RISC V 在手机端的应用生态尚未完全成熟，公司根据市场需求延后了 RISC V 架构开发计划，拟调低对基于 RISC-V 架构的 SoC 平台的投入。

由于市场竞争较为激烈，公司计划取消单芯片大功率电荷泵快充芯片的研发投入，因此，公司拟相应调低对电荷泵快充和光学防抖的技术开发的投入。

BCD 工艺主要向着高压、高功率和高密度三个方向发展。公司涉及数模混合类的智能音频芯片和智能马达驱动芯片进行工艺升级，逐步导入 90nm、55nm、40nm 及更先进的 BCD 工艺。随着手机、工业、车载、物联网、AI 等领域设备智能化趋势，以及其带来的消费体验提升，相应的对这些智能设备所需的模数混合类芯片的功能和性能要求也越来越高。音频功放、摄像头马达驱动、触觉反馈、电容检测等都属于数模混合类 SoC 芯片，集成了模拟的高压处理、和较大规模的数字电路，该部分芯片产品的市场空间将达到百亿元以上，未来规划高压 BCD 先进工艺导入，符合公司产品的发展趋势。目前，业内主流 BCD 工艺为 0.18um BCD 和 90nm BCD 工艺开发，对于大多数模拟及数模混合芯片来讲已满足其应用场景。在先进工艺 BCD 方面，55nm BCD 和 40nm BCD 目前仍处于早期应用和开发阶段，是公司主要的研发投入方向。因此，随着公司工艺节点的不断演进，公司拟加大对高压 BCD 先进工艺导入的投入，以进一步升级和提升产品竞争力。

（三）本次部分募投项目子项目调整的可行性分析

近年来，公司在 90nm BCD 工艺的投入已实现了产品应用。公司具备完整的模拟、数字、后端、算法、软件开发团队及测试、验证、AE、FAE 等平台和支持团队，项目负责人和核心技术人员具有丰富的工作经验且团队稳定，拥有多项相关应用技术、软件算法等专利，可以为研发提供技术保障。因此，公司加大对高压 BCD 先进工艺导入的研发投入具有可行性。

五、本次部分募投项目延期情况

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
发展与科技储备资金项目	2025 年 8 月	2026 年 8 月

（二）本次部分募投项目延期原因

由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对 55nm 和 40nm BCD 先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至 2026 年 8 月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注产业发展方向及市场环境变化，结合公司实际情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使

募投项目尽快达到预定可使用状态。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

2025 年 7 月 27 日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审核通过。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目子项目调整及延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意部分募投项目子项目调整及延期。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目子项目调整及延期的事项，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对本次部分募投项目子项目调整及延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司部分募投项目子项目调整及延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭　捷　　刘煜麟

中信证券股份有限公司

2025 年 7 月 27 日